

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-012

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）编制了截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2305号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”、“利扬芯片”）由东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,410万股，发行价为每股人民币15.72元，共计募集资金53,605.20万元，坐扣不含税承销费3,984.34万元后的募集资金为49,620.86万元，已由东莞证券于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,526.61万元后，公司本次募集资金净额为47,094.26万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-104号）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币52,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金52,000.00万元，实际

募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计（不含税）人民币 711.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,288.91 万元。

上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，公司相关募集资金专户情况如下：

单位：人民币/万元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中国银行股份有限公司东莞万江支行	693873847628	47,094.26	-	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001824	-	-	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801500001485	-	-	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001848	-	-	已注销
合计		47,094.26	-	

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币/万元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中国银行股份有限公司东莞万江支行	734178914347	51,288.91	-	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞金山支行	44050177513509188188	-	-	已注销

中信银行股份有限公司 司东莞东城支行	8110901082665818888	-	7,106.35	存续
中国银行股份有限公司 司东莞万江支行	741948331368	-	-	已注销
合 计		51,288.91	7,106.35	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

请详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》。

2、公开发行可转换公司债券

请详见附表 2《募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）》。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票

2021 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目“芯片测试产能建设项目”新增实施主体利扬芯片，新增实施地点为广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号；将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体由全资子公司上海利扬创芯片测试有限公司（以下简称“上海利扬创”）变更为利扬芯片，实施地点为广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号。详见公司于 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-020）

公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金的用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议、表决程序，其内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

（1）首次公开发行股票

请详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》。

（2）公开发行可转换公司债券

请详见附表 2《募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）》。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2020 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,962.02 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 331.13 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于广东利扬芯片测试股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-601 号）。

2、公开发行可转换公司债券

2024 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二

次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 19,074.29 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 97.88 万元置换已支付发行费用。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于广东利扬芯片测试股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-324 号）。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）请详见附表 3。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）请详见附表 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、首次公开发行股票

“研发中心建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，有助于公司持续丰富测试服务种类，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。

2、公开发行可转换公司债券

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、首次公开发行股票

“芯片测试产能建设项目”累计实现收益与承诺累计收益的差异情况请详见附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）》。

2、公开发行可转换公司债券

“东城利扬芯片集成电路测试项目”尚在建设中，暂不适用累计实现收益与承诺收益的比较。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）首次公开发行股票

2020年11月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币4.0亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及券商理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（2）公开发行可转换公司债券

2024年7月24日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，仅投资于安全性高、

满足保本要求、流动性好的产品。包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买委托理财产品尚未到期的情形。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金结余及节余情况如下：

单位：人民币/万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	47,094.26
截至期末累计发生额	项目投入	B	47,198.92
	利息收入净额	C	104.66
实际结余募集资金		D=A-B+C	-
未使用金额占前次募集资金净额的比例（%）		E=D/A	-

2、公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金结余及节余情况如下：

单位：人民币/万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	51,288.91
截至期末累计发生额	项目投入	B	44,273.68
	利息收入净额	C	91.12
实际结余募集资金		D=A-B+C	7,106.35
未使用金额占前次募集资金净额的比例（%）		E=D/A	13.86

九、前次募集资金使用的其他情况

无其他需要说明的情况。

附表 1：《前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》

附表 2：《前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）》

附表 3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）》

附表 4：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行人转换公司债券）》

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表
(首次公开发行股票)
截至 2025 年 9 月 30 日

金额单位：人民币/万元

募集资金总额：			47, 094. 26			已累计使用募集资金总额： 47, 198. 92				
						各年度使用募集资金总额：			47, 198. 92	
变更用途的募集资金总额：						2020 年：		10, 401. 53		
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：		36, 557. 95		
						2022 年：		239. 44		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	芯片测试产能建设项目	芯片测试产能建设项目	31, 800. 06	31, 800. 06	31, 904. 72	31, 800. 06	31, 800. 06	31, 904. 72	104. 66 ^{注1}	2022 年 12 月 ^{注2}
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	10, 294. 20	10, 294. 20	10, 294. 20	10, 294. 20	10, 294. 20	10, 294. 20		2021 年 11 月
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00		不适用
合计			47, 094. 26	47, 094. 26	47, 198. 92	47, 094. 26	47, 094. 26	47, 198. 92	104. 66	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 104.66 万元系利息收入净额；

注 2：“芯片测试产能建设项目”募集资金于 2022 年 12 月末投资完毕，募投测试设备到厂后，仍须经安装、调试等流程，方可最终达到预计可正常使用状态。

附表 2

前次募集资金使用情况对照表
(公开发行可转换公司债券)
截至 2025 年 9 月 30 日

金额单位：人民币/万元

募集资金总额：			51,288.91			已累计使用募集资金总额：44,273.68				
						各年度使用募集资金总额：			44,273.68	
变更用途的募集资金总额：						2024 年：		28,480.15		
变更用途的募集资金总额比例：						2025 年 1-9 月：		15,793.53		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	东城利扬芯片集成电路测试项目	东城利扬芯片集成电路测试项目	49,000.00	49,000.00	41,976.12	49,000.00	49,000.00	41,976.12	-7,023.88	2028 年 12 月 ^{注2}
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	3,000.00	2,288.91	2,297.56	3,000.00	2,288.91	2,297.56	8.65 ^{注1}	不适用
合计			52,000.00	51,288.91	44,273.68	52,000.00	51,288.91	44,273.68	-7,015.23	

注 1：截至 2025 年 9 月 30 日，公司“东城利扬芯片集成电路测试项目”承诺投入金额未发生变化，“截至期末承诺投入金额”与“募集资金承诺投资总额”保持一致；“补充流动资金项目”与承诺投入金额差异金额为人民币 8.65 万元，全部系银行利息收入所致，其全部作补充流动资金使用。

注 2：2026 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，将募集资金投资项目“东城利扬芯片集成电路测试项目”达到预定可使用状态时间延长至 2028 年 12 月。

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(首次公开发行股票)
截至 2025 年 9 月 30 日

金额单位：人民币/万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度		
1	芯片测试产能建设项目 ^{注1}	63.95% ^{注2}	项目达产后,可实现销售收入 22,455.11 万元 ^{注3}	11,187.60	13,187.86	8,903.66	不适用	33,279.12	否
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“芯片测试产能建设项目”总投资金额为 40,991.20 万元，其中募集资金投入 31,800.06 万元，不足部分 9,191.14 万元使用自有或自筹资金投入；截止 2022 年 12 月，公司通过募集资金和自有或自筹资金对募投项目全部投入，但由于测试设备单台价值较高，预付订购款项至到厂的周期较长，交付后需要进行安装、调试并最终达到预计可正常使用状态需要一定的时间，因此 2022 年度未产生实际效益；

2023 年度至 2024 年度，随着设备陆续到厂并安装、调试，测试产能逐步释放，但期间受宏观经济及市场环境等综合因素影响，部分测试需求短暂下滑，产能释放进度不及预期，导致实际效益低于承诺效益；为此，在积极维护存量客户的情况下，进一步拓展市场，公司重点围绕工业控制、高算力（CPU、GPU、ISP 等）、汽车电子、5G 通讯、传感器（MEMS）、人工智能（AI）、存储（Nor/Nand Flash、DDR、HBM 等）、智能物联网（AIoT）、无人驾驶、机器人等领域作为目标市场，新拓展客户新产品将陆续导入并实现量产测试，争取早日达产。

注 2：“截止日投资项目累计产能利用率”系指 2025 年 1-9 月综合平均产能利用率；

注 3：根据“芯片测试产能建设项目”的经济效益概算，该项目完全达产年份可实现销售收入 22,455.11 万元；项目完全达产后可实现销售收入仅用于项目经济效益概算，不构成盈利预测或业绩承诺。

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(公开发行可转换公司债券)
截至 2025 年 9 月 30 日

金额单位：人民币/万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度		
1	东城利扬芯片集成电路测试项目 ^注	不适用	项目达产后，预计稳定运营后将实现年营业收入 64,571.98 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]截至 2025 年 9 月 30 日，“东城利扬芯片集成电路测试项目”按计划正在建设中。